愛普科技股份有限公司

2026.11.10 法人說明會

大家午安，我是愛普科技投資人關係 Cindy，歡迎各位投資先進參與愛普科技法人說明會，在會議的初段，我們將進行本公司 2026 年第三季的財務狀況及業務報告，簡報過後會進入問答階段，線上參與的投資朋友可於畫面右下角欄位輸入您的問題，我們將於整理後統一回覆。

第 2 頁免責聲明的部分再麻煩各位留意。

第 3 及第 4 頁是愛普科技的簡要資料，提供各位參考。

本次法說會會先由林郁昕財務長說明 2026 年第三季財務數字重點，接著洪志勳總經理將報告營運狀況以及未來展望，之後進行 Q&A，今日的與會團隊除了洪志勳總經理及林郁昕財務長之外，還有陳文良執行長、薛澤源業務中心資深副總、張堅產品中心資深副總以及劉宗寧產品中心副總也會在線上回覆問題。

首先請林郁昕財務長進行財務狀況報告。

財務狀況及業務報告

林郁昕 財務長

大家好，我是林郁昕。首先說明 2026 年第三季的合併損益情形，愛普 2026 年第三季單季合併營收創下歷史新高，為新台幣 33.1 億元，較上季增加 40%，較去年同期則增加 122%，營收增加最主要來自於 IoTRAM™的需求維持強勁及價格調漲，另外矽電容產品線進入量產後銷售持續成長，也推升了營收 YoY 增長。

第三季毛利金額為 18.5 億元，毛利金額 QoQ 及 YoY 分別增加 60%及 170%；本季毛利率為 56%，QoQ 增加 7 個百分點，YoY 增加 10 個百分點，毛利率的增加主要是來自於記憶體產品銷售價格的提高。稍後會再做細部說明。

逐字稿以忠實呈現談話內容為主，然為求語句通順已修飾多餘贅詞

本季營業費用為 5 億元，較上季增加約 6,600 萬元，QoQ 增加 15%；較去年同期增加 1.9 億元，YoY 增加 63%；營業費用的增加反映了團隊規模的成長，同時獎酬費用隨著獲利而增加、研發專案的開展投入也都影響了營業費用的增加。本季營業費用率為 15%，因營收增加分別較上季及去年同期減少 3 個百分點及 6 個百分點。隨著公司營收持續成長，營業費用率預期將逐步下降。

營業利益為 13.6 億元，QoQ 及 YoY 分別增加 87%及 256%；本季營業利益率為 41%，QoQ、YoY 因毛利率上升及營業費用率下降而分別增加 10 個百分點及 16 個百分點。

業外收支部分，第三季業外淨收入為 1.1 億元，主要來自於兌換利益 2,000 萬元及利息收入 9,200 萬元。

美元兌新台幣匯率第三季底與第二季底相同，本季認列的 2,000 萬元兌換利益來自季度內公司日常換匯造成的損益。

先說明一下 2022 年 GDR 未支用資金的情形：本公司在第二季取得中央銀行核准，將該次的 GDR 資金運用計畫從購置機台設備等資本支出全數轉為充實營運資金，以支應公司在 S-SiCap™ 新產品陸續量產所帶動的營運擴張，本公司在第 2-3 季支用約 47%，剩餘未支用的 1 億美元部位，預計可於明年第一季度動撥完畢。排除 2022 年 GDR 相關兌換損益及所得稅影響數的擬制設算資料會在下一頁做說明。另外，我們在今年十月份完成了新一輪 GDR 籌資作業，還未包含在第三季的財務數字中，稍後也會再做說明。

第三季稅前淨利為 14.7 億元，所得稅費用 3.1 億元，有效稅率為 21%，稅後淨利金額為 11.6 億元，其中歸屬於本公司業主的稅後淨利為 11.8 億元，因本業獲利大幅增長，季增 73%及年增 66%，歸屬於本公司業主的稅後淨利率為 36%，單季每股盈餘為 7.21 元。

因第三季底美元兌新台幣匯率與第二季底相同，因此排除 2022 年 GDR 未支用資金所產生的兌換損益後之財務數據與排除前一致，前期及去年同期擬制調整後的數據亦提供給各位投資先進參考。

合併資產負債表的部分，季底總資產為 167 億元，較第二季底減少 1.7 億元。其中，現金及約當現金為 89 億元，按攤銷後成本衡量的金融資產（也就是三個月以上的定期存款）為 15 億元，總計金額約 104 億元，合計占總資產的 62%。這兩個科目的合計數，QoQ 淨

逐字稿以忠實呈現談話內容為主，然為求語句通順已修飾多餘贅詞

減少數約 18.8 億元，除了營運活動應收、應付款項的收付外，第三季支付現金股利 11 億元，以及簽訂長期產能合作協議的預付款項是比較主要的現金流出項目。

本季底應收帳款 12.5 億元，較第二季底增加 4.6 億元，收款天期則維持在 1-2 個月，整體應收帳款回收狀況良好。存貨金額為 18.9 億元，較第二季底增加 3.2 億元，增加 20%，目前庫存大約維持 4-5 個月，將持續依據產能狀況、接單情形來相應動態管理。

本季底按公允價值衡量的金融資產 3.7 億元，較第二季底增加約 9,400 萬元，主要是本季增加對 HamminX 的投資約 6,000 萬元，並隨著估值增加，認列 3,300 萬元其他綜合損益，會反映在股東權益的項目中；HamminX 從事 CXL 模組的設計開發，愛普持有約 16%。

本季底的總負債為 27.2 億元，負債比率為 16%，較第二季底減少 14 億元，主要來自於現金股利的支付及合約負債轉為營收的淨影響數。YoY 負債比率增加 2 個百分點，主要是合約負債、應付帳款及應付所得稅的增加。公司把客戶的預付款列為合約負債。

股東權益總金額為 140 億元，扣除非控制權益 1.7 億元，歸屬於本公司業主的權益金額為 138.3 億元，較第二季底增加 12.6 億元，每股淨值為 84.75 元。

接下來幾張投影片，我會說明幾個主要財務數字的趨勢變化。

首先是季度營收及毛利率的變化。2026 年第三季的合併營收達到歷史新高，從產品別來看，QoQ 營收的增加主要來自於 IoTRAM™產品線；YoY 部分則是來自於 IoTRAM™以及 S-SiCap™的營收增長。

IoTRAM™本季營收占比達 82%，營收金額為 27.2 億元，季增 61%；YoY 則是大增 146%。

VHM™產品線本季營收為 2,400 萬元，主要是 NRE 收入，營收較第二季減少 1,300 萬元左右，YoY 則減少 5,300 萬元，本季占比為 1%。

S-SiCap™產品線本季營收為 5.7 億元，QoQ 減少 10%，YoY 則增加 82%，主要來自 S-SiCap™ Interposer（也就是 IPC）多個專案進入量產的挹注。S-SiCap™產品線本季營收占比約 17%。

逐字稿以忠實呈現談話內容為主，然為求語句通順已修飾多餘贅詞

這邊我們再進一步說明一下毛利率的變動，本季毛利率為 56%，較第二季增加 7 個百分點。其中 9.5 個百分點的增加來自於單位售價調漲及成本上升的淨影響，而本季因工程品存貨評價的調整，提列約 2.5 個百分點的存貨跌價，兩者相抵後毛利率季增 7 個百分點。

本頁說明公司營業費用的趨勢，直條圖深綠色部分為研發費用，淺綠色則為銷售及管理費用，折線代表的是營業費用率。第三季營業費用為 5 億元，營業費用隨著團隊規模擴增及研發專案開展，呈現逐季穩步成長，其中研發費用約占營業費用的三分之二，預期將隨著研發人力佈建及專案開展而持續增加。本季營業費用率為 15%，主要是隨著營收規模持續擴大，帶動整體營業費用率的下降。

接下來說明一下盈利狀況。在這一頁左方淺綠色是營業利益，第三季的營業利益為 13.6 億元，最近幾季營業利益隨著營收增長呈現逐季增加的趨勢。本季營業利益率為 41%，QoQ、YoY 皆因營收和毛利率雙雙增加以及營業費用率下降的影響，分別增加 10 個百分點及 16 個百分點。

右手邊的圖是業外淨收支，主要是由兌換損益、利息收入及金融資產評價損益所組成，業外因公司有較大的外幣部位，會隨著匯率升貶而有比較大幅度的波動。本季金額主要來自小額兌換利益及利息收入。

歸屬於本公司業主之淨利部分，隨著營收強勁成長，毛利率提高，整體營業利益較第二季大幅增長之下，第三季歸屬於本公司業主之淨利為 11.8 億元，較第二季及去年同期皆呈現大幅成長狀態。

另外，本公司 2026 年度新發行的 GDR 在 10 月 12 日取得金管會核准函，並且在同一天完成訂價，10 月 15 日順利完成發行。本次 GDR 共發行 740 萬單位，對應增加發行普通股 1,480 萬股，股權稀釋比例約為 8.32%，每單位發行價格為美金 56.15 元，募集總金額約 4.16 億美元。透過此次募資，公司可以進一步充實資本結構以及外幣資金部位，以支應未來營運成長的需求。本次募集資金將用於外幣購料，有助於支持 S-SiCap™ 新產品量產所帶來的業務擴張與營運成長。同時，透過此次國際資本市場籌資，公司也進一步提升國際市場能見度與投資人基礎，對公司長期發展及股東價值具有正面助益。

以上是就財務資訊的相關說明，接下來時間由洪志勳總經理說明營運狀況，謝謝！

逐字稿以忠實呈現談話內容為主，然為求語句通順已修飾多餘贅詞

洪志勳 總經理

謝謝財務長。各位投資先進大家好，接下來由我為大家報告第三季的營運狀況。

本季營運報告將延續之前的架構，分為 IoTRAM™、S-SiCap™以及 VHM™ 三個產品線分別向各位報告業績狀況。

接下來我就三個產品線在今年第三季的營運狀況為各位說明。

首先我們來看 IoTRAM™產品線。

IoTRAM™延續強勁成長動能，本季營收 27.2 億元，較前季增加 61%， YoY 則增加 146%。IoTRAM™有三個主要應用領域，包括 Connectivity、Wearable 及其他。

首先是 Connectivity，在本季 IoTRAM™營收占比約 38%，QoQ 增加 72%，YoY 則增加 109%。

其次是穿戴裝置的部分，本季營收占 IoTRAM™27%，金額較前季增加 69%，YoY 成長 113%。

其他應用的部分在本季營收也呈現成長態勢，主要是 Display 客戶的需求上升。QoQ 及 YoY 分別增長 45%以及 261%，在本季 IoTRAM™營收占比 35%。

接下來我針對 IoTRAM™的營運進展，向各位進一步說明。

本季 IoTRAM™各項應用市場需求持續強勁，整體訂單需求明顯高於目前可供應的產能，預期在 2027 年會是一樣的趨勢，IoTRAM™會持續成長。

再往更長期看，由於成熟製程的供給相對有限，我們預期供需關係會保持長期穩定。

在高頻寬、低功耗的 ApSRAM™產品，許多穿戴裝置的主流客戶已經廣泛地導入在他們新一代的產品上，同時也有許多 MCU 的大廠採用 ApSRAM™在他們新一代的智慧型微處理器上，以滿足 AI 功能所需要的記憶體頻寬及容量，我們看好此一發展趨勢將為 ApSRAM™帶來更多元的市場機會。隨著產品組合與容量規格持續擴充，可望進一步拓展應用範圍，以滿足不同客戶及終端市場對高效能、低功耗記憶體的需求。

同時，我們也專注在 IoTRAM™整體生態系的建立。在 IoTRAM™控制器 IP 方面，我們與許多廠商合作，為客戶提供成熟的 IoTRAM™ controller IP，以縮短客戶產品開發時間及減少設計風險。

接下來是 S-SiCap™產品線。

S-SiCap™產品線涵蓋我們矽電容產品的各種形式，包括了矽電容中介層（Interposer with S-SiCap™），我們稱作 IPC，以及分離式矽電容，我們叫做 IPD，IPD 包括了嵌入基板（Embedded-in-Substrate）以及在基板底側（Landside）的應用。

IPC 部分，第三季出貨受到力積電銅鑼廠機台遷移的影響，產出受到短期干擾，本季營收略有下降。目前相關機台已於第四季逐漸恢復運作，生產逐步回歸正常，預期 IPC 的營收會隨著產能恢復而逐步回升。

在 IPD 嵌入基板（Embedded-in-Substrate）的應用，已於第二季開始量產，相較原來的計畫有提前，並且需求爬升的速度非常快，預期未來出貨量將逐季成長，我們樂觀看待 IPD 在 2027 年對公司營收所帶來的顯著貢獻。

另外，Landside IPD 目前客戶主要應用於旗艦型智慧手機及 AI 穿戴裝置的主晶片搭配方案，自第二季開始，旗艦手機的應用已進入穩定量產，穿戴裝置產品部分的驗證已經完成，預計明年進入量產。Landside IPD 在高階終端應用市場也建立了穩固的基礎。

隨著 AI 以及 HPC 應用快速發展，市場對高效能矽電容的需求不斷提升，愛普也持續深化與供應鏈各環節夥伴的策略合作。除了現有的產能保障協定之外，我們也持續擴大產能資源與供應鏈布局，以提升整體供應能力，更有效滿足客戶不斷增加的需求。

接下來我們看 S-SiCap™的營收，本季營收 5.7 億元，其中 IPC 占比約七成，QoQ 減少三成左右。

IPD 本季營收季增 3 倍多，佔 S-SiCap™營收比重約三成，主要是新產品進入量產後，營收成長動能明顯增強的挹注。

接下來我們來看 VHM™產品線。

本季營收 2,400 萬元，較前季減少，主要是 NRE 收入較前季減少的原因。YoY 金額也減少 5,300 萬元。VHM™產品線目前營收主要是 NRE 的收入，少量 wafer sales 則是工程樣片的出貨。

逐字稿以忠實呈現談話內容為主，然為求語句通順已修飾多餘贅詞

VHM™ 產品線目前處於開發的階段。本季我們已完成一項大語言模型（LLM）AI 推論加速器的記憶體設計，這是 VHM™ 技術拓展至 AI 運算應用的重要進展，預期 2028 年進入量產，為 VHM™ 產品線開啟新的應用市場與成長機會。

另一方面，隨著 3D 堆疊技術持續發展，整體產業生態系也逐漸趨向成熟，客戶有更多元的選擇，將進一步帶動 3D 堆疊供應鏈的成長機會。

以上是三個產品線在第三季的 Update。

最後，我就愛普的未來展望向各位報告。

愛普在今年隨著 IoTRAM™的強勁需求以及 S-SiCap™的 IPD 從今年第二季進入量產後需求迅速爬升，我們預期 2027 年將維持高速成長趨勢。

在 IoTRAM™部分，客戶的需求依然高於產能。另外，穿戴裝置以及 Smart MCU 的客戶要求更高的記憶體頻寬、更大的容量，我們的 ApSRAM™ 正是符合這個規格需求，預期 ApSRAM™在未來幾年會是 IoTRAM™的成長動能。

IPD 在嵌入基板應用的需求很強，客戶要求出貨的爬升速度也很快，預期在 2027 年會有數倍的成長；IPC 的營收在第四季也會逐漸恢復。

VHM™專案目前順利進行中，量產出貨大概會落在 2028 年。

為因應客戶需求，我們預期還需要更多的產能，目前與晶圓廠及封測廠持續協商中。

另外，我們在十月份已經完成的 4.16 億美元 GDR 募資，這次募資目的主要就是要支應營運資金以及支持快速成長的資金需求。

以上是我的報告，謝謝。

逐字稿以忠實呈現談話內容為主，然為求語句通順已修飾多餘贅詞

Q&A

謝謝總經理。本次的簡報到這裡告一段落，接下來進入問答階段，請各位投資先進於畫面右下角欄位輸入您的問題，我們將於整理後統一回覆，謝謝。

問題：請問 4Q26 與 2027 年的營收展望及主要驅動因素為何？

回答：薛澤源 業務中心資深副總

延續第三季的市場動能，我們樂觀看待第四季營收，主要動能仍來自市場對 IoTRAM™ 的強勁需求，以及矽電容產品線出貨量持續提升。展望 2027 年，矽電容產品預期將會維持高速成長，成為推動公司營收成長的主要驅動力。

問題：Embedded-in-Substrate IPD 在 4Q26 及 2027 年的量產爬坡進度？出貨量是否可望逐季成長？除 EMIB 外，有看到其他客戶或應用導入嗎？

回答：薛澤源 業務中心資深副總

六個多月以來，IPD 量產規模持續穩健擴大。EMIB 是 2.5D 封裝，Embedded-In-Substrate 的應用除了 EMIB 之外也有非 2.5D 封裝的客戶，除 Substrate 應用外，IPD 也已經成功導入 Landside 客戶並進入量產階段，帶動出貨表現逐季成長。展望 2027 年，愛普最重要的任務是全力提升供應能力，才能夠充分滿足客戶持續增長的需求。

問題：PSMC 遷廠對 SiCap Interposer 造成的干擾是否已排除？應如何估算第 4 季出貨回補所帶來的貢獻以及後續營收走勢？

回答：洪志勳 總經理

就如同剛才的報告，PSMC 的機台已經陸續恢復生產，這對 SiCap Interposer 的營收影響大概會是在本季以及第四季初左右，這部份的影響是交貨延期，而不是訂單取消。隨著產

逐字稿以忠實呈現談話內容為主，然為求語句通順已修飾多餘贅詞

能的恢復，我們預期營收在第四季逐漸恢復之後，明年會繼續成長。

問題：市場傳出 Google TPU v9 的量產出貨時程延後至 1Q28，對愛普 IPD 業務有何影響？

回答：劉宗寧 產品中心副總

對於市場傳聞我們不會做任何猜測或連結，也不會對特定客戶做說明。我們目前看到 IPD 的需求仍舊是快速成長。

問題：IPD 市場規模及愛普市佔率為何？隨著更多競爭者進入，未來是否可能面臨價格競爭壓力？

回答：劉宗寧 產品中心副總

我們認為整體矽電容的市場規模會隨著 AI 晶片及先進封裝的成長而成長，而愛普是目前少數量產的供應商之一。未來一定存在價格競爭，但對於矽電容的主流應用來說，更重視產品的量產經驗和品質可靠度，價格只是競爭的因素之一。

問題：目前 IPD 客戶的需求能見度如何？公司產能可滿足多少需求？是否有擴產計劃？

回答：薛澤源 業務中心資深副總

目前客戶需求的能見度到 2027 年下半年，如前所述，我們會全力提升供應能力，來充分滿足客戶持續增長的需求。

問題：公司與聯電合作的產品項目有哪些？各產品的量產時程為何？其中是否包含供應 Intel EMIB-T 平台的 IPD 業務？

回答：洪志勳 總經理

我們與聯電在 DTC 的合作計畫有通過新聞稿公布，IPD 驗證已經完成，現在也有幾個客戶在導入當中，量產時程目前還不確定。至於特定客戶應用的部分，我們不方便回答。

逐字稿以忠實呈現談話內容為主，然為求語句通順已修飾多餘贅詞

問題：聯電提到規劃 DTC 矽電容月產能 2.2 萬片，是否將全數供應愛普？

回答：洪志勳 總經理

基本上我們是依據需求成長來規劃產能，對聯電產能的需求，目前還在規劃以及協商當中，如果有進一步的進展，我們會再向各位先進報告。

問題：隨著 IPD 業務規模擴大，應如何看待公司長期毛利率水準？個別產品線（IoTRAM™、IPC、IPD、VHM™）的毛利率區間為何？

回答：洪志勳 總經理

以長期來說，我們預期公司整體毛利率會維持在 45-50%左右。至於個別產品線的毛利預估，IoTRAM™以及 S-SiCap™大約會落在平均值附近，VHM™的 NRE 因為是 design service 的收入，毛利率會是 100%，但在 Wafer Sales 部分，大概也會落在毛利率的平均水準附近。

問題：公司怎麼看未來幾季的代工價格漲價壓力？成本是否能夠轉嫁給客戶？若能，預計何時會反映在價格上？

回答：薛澤源 業務中心資深副總

愛普與晶圓代工及後段封測夥伴都建立了長期穩定的合作關係，所以在價格的調整上，都可以在合理且可預期的架構下進行討論與規劃。

客戶端，在積極滿足需求的同時，我們也與策略客戶保持緊密溝通，透過適當機制共同分攤並管理成本上升所帶來的壓力。在反映的時間點上，價格和成本各自反應市場的時間不會是完美重合，所以在市場上下波動的時候，毛利率可能會有小範圍的波動。

問題：IoTRAM™的營收展望為何？成長主要來自價還是量？當標準型 DRAM 價格回歸常態之後，成長動能還能維持多少？

回答：薛澤源 業務中心資深副總

逐字稿以忠實呈現談話內容為主，然為求語句通順已修飾多餘贅詞

基於愛普對生態系長期且持續的投入，我們也看到應用場景不斷擴展，客戶需求多樣化且持續成長，我們對 IoTRAM™市場未來的發展前景維持樂觀看法。我們所說的成長，主要是指量的成長。

相對於標準型 DRAM 市場，愛普長期所經營的客製化 IoTRAM™供需結構與價格走勢相對穩定，但是價格還是會一定程度地反映市場供需的變化。

IoTRAM™的營收雖然短期可能受到景氣循環而出現波動，但我們對中長期穩健成長趨勢的看法不會改變。

問題：ApSRAM™預計何時開始顯著貢獻營收？相較於 PSRAM，ASP 可望提升多少？是否有營收佔比目標？

回答：薛澤源 業務中心資深副總

ApSRAM™ 從今年下半年開始量產出貨，已經開始貢獻 IoTRAM™ 產品營收，2027 年相關效益會進一步顯現。目前，愛普持續投入工程與研發資源，來協助 MCU 與 SoC 客戶加速完成設計導入及量產落地，充分發揮 ApSRAM™ 超低功耗與超高頻寬的技術優勢，為終端產品和客戶帶來更卓越的使用體驗。我們持續看好 ApSRAM™ 未來的市場潛力，也期待其營收貢獻隨客戶量產規模增大而提升。至於具體的 ASP 和營收比例目標的細節訊息，我們目前還沒有準備要公開報告。

問題：考量消費性電子市場面臨記憶體價格上升壓力，是否有看到客戶放緩規格升級的步調？

回答：劉宗寧 產品中心副總

客戶的規格升級通常是比較長期的規劃，不太會受短期價格的影響。目前比較明顯的規格升級會是穿戴裝置和智慧終端裝置需要更高的記憶體容量來滿足 AI 的需求。這個升級的步調並沒有受到短期價格的影響。

逐字稿以忠實呈現談話內容為主，然為求語句通順已修飾多餘贅詞

問題：VHM™在 2028 年量產爬坡之前，未來 12 個月預計有哪些重要里程碑或參考指標嗎？

回答：陳文良 執行長

我們在 VHM™量產之前應該會看到一些樣品出貨的營收，會反映在 VHM™的 Wafer Sales。同時我們也會在每季法說會報告相關的進展。

問題：VHM™的產品定位和目標客戶為何？相較於 zHBM、SoIC、HBC 的差異化優勢？

回答：劉宗寧 產品中心副總

VHM™ 跟這些技術都是利用 3D 堆疊的解決方案，其中 VHM™能夠在最低功耗下提供最高頻寬，我們認為是最適合 AI 推論 ASIC 晶片的解決方案，也可以說 VHM™是 3D 堆疊的終極優化版本。

問題：公司分散代工廠的布局進展如何？預計何時開始量產，可以為公司帶來多少新增產能？

回答：洪志勳 總經理

剛才有提到，S-SiCap™跟一些晶圓廠的合作持續進行中，我們先前也與聯電共同發布新聞稿，IoTRAM™也有客戶驅動的一些專案在其他晶圓廠 tape-out，這些專案目前還是在非常初期的階段，距離量產大概還要 1-2 年左右。目前沒有比較明確的一些產能訊息可以分享，同時我們也希望能夠跟這些供應商成爲長期合作夥伴，有進展會持續向各位先進報告。

問題：在產能不足的情況下，公司如何平衡 IoTRAM™、IPC 及 IPD 的產能配置？公司是否考慮將部份 IoTRAM™或 IPC 產能轉供 IPD 產品？

回答：洪志勳 總經理

公司的產能是按照各產品線的長期需求來做規劃，例如我們最近為 IPD 跟晶圓廠及 OSAT 簽了產能協定，但難免可能會有產能不足的狀況，在產能不足的時候，公司首要滿足長期策略客戶的實際需求，具體情況較複雜，在這裏不方便說得太具體。

逐字稿以忠實呈現談話內容為主，然為求語句通順已修飾多餘贅詞

問題：力晶創新投控提名陳文良董事長為監察人候選人，請問此舉對愛普與力積電未來合作關係有何意義？雙方在業務或技術合作上是否會進一步深化？

回答：陳文良 執行長

力積電一直是愛普最重要的長期夥伴之一，力晶創新投資是力積電的單一最大股東，但是兩家公司的營運是獨立的，所以這件事跟愛普沒有直接的關係，當然也希望對愛普和力積電的長期夥伴關係有一些間接的幫助。

本人被邀請做力晶創新的監察人候選人，主要是因為力晶創新計劃加強半導體專業人士在董監事的席次，進一步發揚力晶創新投資在半導體業的成功投資經驗，在 AI 的新時代為廣大股東做出更好的回報。

問題：本次 GDR 募資是否足以支應 S-SiCap™業務擴張需求？未來是否仍有籌資規劃？若有，公司較傾向發債還是發股？

回答：林郁昕 財務長

以目前的 business plan 來看，這次 GDR 募得的資金足以支持我們現階段，包括 S-SiCap™快速成長所需要的營運資金。

當然，如果未來業務成長明顯超過目前預期，或公司有新的策略性投資機會，我們會視當時的資金需求與資本市場條件，來選擇最適合公司的融資方式。這一次公司處於高速成長期，所以選擇用股權當作籌資工具，避免擴張財務槓桿；但隨著未來公司規模、獲利及現金流進一步擴大，營運更加成熟，債務工具的吸引力會相對提高，我們不一定再次透過股權增資，也不排除未來優先考慮 CB、ECB 或銀行融資這些債務工具。

問題：如何看待 IVR 對 S-SiCap™需求的影響？目前相關專案進度如何，預計何時可以量產？

回答：陳文良 執行長

IVR 的功能是在晶片封裝內部做高電壓到低電壓的轉換，進而降低在線路板上供電系統的電流負擔和損耗。

如果沒有 IVR 的導入，低壓矽電容的需求幾乎和晶片的功耗成正比成長，這個趨勢，長期來看明顯是不可持續的，所以隨著晶片功耗的增加，IVR 的導入是一個必然的趨勢，IVR 的導入會減緩對低壓矽電容需求的增加，但是會增加對高壓矽電容的需求。

我們對這個趨勢有密切的關注，也通過投資和合作跟 IVR 的產業夥伴有密切互動，我們的商業模式還是提供最優化的矽電容，量產的時間現在還有點難說。

問題：VHM™ Stack 2024 年的驗證完成，上次法說洪總也提到目前已進入產品實現的階段，而且已經有幾家量產專案在開發階段，甚至有 1+8 層的堆疊順利完成，還有新的 Data Center and Edge AI 的量產專案也與客戶在討論當中，以上 VHM™的相關產品量產時程可以具體說明會在何時能有第一項產品出貨嗎？前期法說陳董有約略提到 2027 年可能會有第一個量產營收，目前這樣的進度依然沒變嗎？以目前的進度，2027 年有機會能量產出貨嗎？VHM™的量產快速成長期將可能落在什麼時候？

回答：陳文良 執行長

VHM™的客戶專案目前都順利進行中，我們還是預計量產會落在 2028 年。2027 年可能有一些樣品出貨，比較顯著的貢獻會落在 2028 年。

問題：整體矽電容的營收貢獻在 2027 年將有數倍的營收成長，甚至有機會能超越 IoT 的營收，目前仍維持這樣的看法嗎？

回答：薛澤源 業務中心資深副總

IPD 在今年下半年進入量產，客戶需求拉得很急，目前產能還沒辦法趕上客戶需求，預計明年產能打開之後，IPD 對營收會有很大的貢獻。簡而言之，我們對 IPD 的看法沒有改變。

問題：近期同業（如華邦電）宣佈將矽電容密度推升至 5.4 uF/mm^2。愛普下一代 Gen 5 S-SiCap™在單位面積電容密度的研發目標進度為何？此外，在嵌入式 ABF 載板與晶片背面（LSC）的超薄化厚度上，愛普相比傳統深槽式（DTC）同業的實體領先優勢為

逐字稿以忠實呈現談話內容為主，然為求語句通順已修飾多餘贅詞

何？

回答：劉宗寧 產品中心副總

矽電容的重點在於如何滿足各種客製化的需求，我們一直以來都注重和客戶深度合作以及定義技術藍圖，提供最有競爭力的規格和產品。

問題：目前愛普的矽電容產品是否因為客戶先進封裝良率較低的傳聞而受到影響，具體會如何影響？會因此而營收認列遞延嗎？

回答：陳文良 執行長

愛普矽電容的商業模式是賣 KGD（Known Good Die），客戶的良率波動對我們沒有直接的影響，更不會影響到我們對營收的認列。

問題：2027 年 S-SiCap™營收是否會大於 IoTRAM™，預計會在哪一個季度看到？

回答：洪志勳 總經理

我們在上一季有提到 S-SiCap™在 2027 年有機會大於 IoTRAM™，我們指的是整年度營收的比較，而不是在哪一季會達成。

問題：公司近期與聯電合作開發的矽電容是屬於深溝槽式（DTC）架構嗎？請教這項合作在愛普 S-SiCap™產品藍圖中扮演何種定位（例如與傳統 Stack 堆疊式的分工）？主要瞄準的終端應用（如 AI 伺服器、車用或高頻通訊）為何？面對村田與華邦電等 DTC 同業，愛普在 DTC 矽電容上的實體競爭優勢為何？

回答：陳文良 執行長

我們最近跟聯電合作的電容技術確實是 DTC (Deep Trench Capacitor)，有別於已經在做的 Stack Capacitor，這兩個技術路線在應用定位上主要取決於客戶的需求，客戶不同需求會有不同選擇，我們在這個行業主要的應用場景是 AI 伺服器和手機 SoC，而愛普目前的競爭優勢主要是先行優勢，因為我們走得早，所以在客戶關係和產業經驗上都有些積累。

逐字稿以忠實呈現談話內容為主，然為求語句通順已修飾多餘贅詞

由於時間關係，問答階段在此告一段落，會後若有其他問題，歡迎各位投資先進聯繫本公司 IR 團隊。感謝各位的參與，今天的會議到此結束。謝謝!

聲明

若逐字稿內容與法說會現場陳述內容有不一致之處，應以法說會現場陳述內容為準。

上述訊息所提供對於產業及本公司前景之預測，係根據目前營運及公開資訊所做出之判斷，相關內容具風險與不確定性，任何外在環境的改變均可能影響公司實際營運與財務狀況。，

上述訊息中所提供之資訊，不代表本公司對產業狀況或後續重大發展的完整論述，本公司亦不會因任何新的資訊或事件而更新相關資訊。